

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 3 月 14 日(14.03.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/035871 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/072987
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 7 日(07.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
PCT/JP2011/070653 2011 年 9 月 9 日(09.09.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ヘンケル・アクチェンゲゼルシャフト・ウント・コムパニー・コマンディットゲゼルシャフト・アウフ・アクチェン(HENKEL AG & Co. KGaA) [DE/DE]; 40589 デュッセルドルフ ヘンケルシュトラッセ 67 Duesseldorf (DE).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 堀口 有亮(HORIGUCHI, Yusuke) [JP/JP]; 〒2350017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町 2 7-7 ヘンケルジャパン株式会社内 Kanagawa (JP). 佐野 美恵子(SANO, Mieko) [JP/JP]; 〒2350017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町 2 7-7 ヘンケルジャパン株式会社内 Kanagawa (JP). 佐藤 憲一朗(SATO, Kenichiro) [JP/JP]; 〒2350017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町 2 7-7 ヘンケルジャパン株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 伊藤 克博, 外(ITO, Katsuhiko et al.); 〒1030025 東京都中央区日本橋茅場町 3 丁目 1 0 番 9 号 ティーエスビル 7 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第 21 条(3))

(54) Title: SEALANT COMPOSITION FOR ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 電子装置用シール剤組成物

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a sealant composition for an electronic device, that does not generate problems during work even when heated, in a mounting step for the electronic device. This invention pertains to the sealant composition for the electronic device, that includes a compound (a) having at least 2 (meth) acryloyl groups, and a nitroxide compound and/or a thiocarbonylthio compound (c).

(57) 要約: 本発明は、電子装置の実装工程において、加温しても作業に問題を生じない電子装置用シール剤組成物を提供することを目的とする。本発明は、(a) 2 以上の(メタ)アクリロイル基を有する化合物と、(c) ニトロキンド化合物および/またはチオカルボニルチオ化合物とを含む、電子装置用シール剤組成物に関する。



WO 2013/035871 A1